

作业内容

制板检查

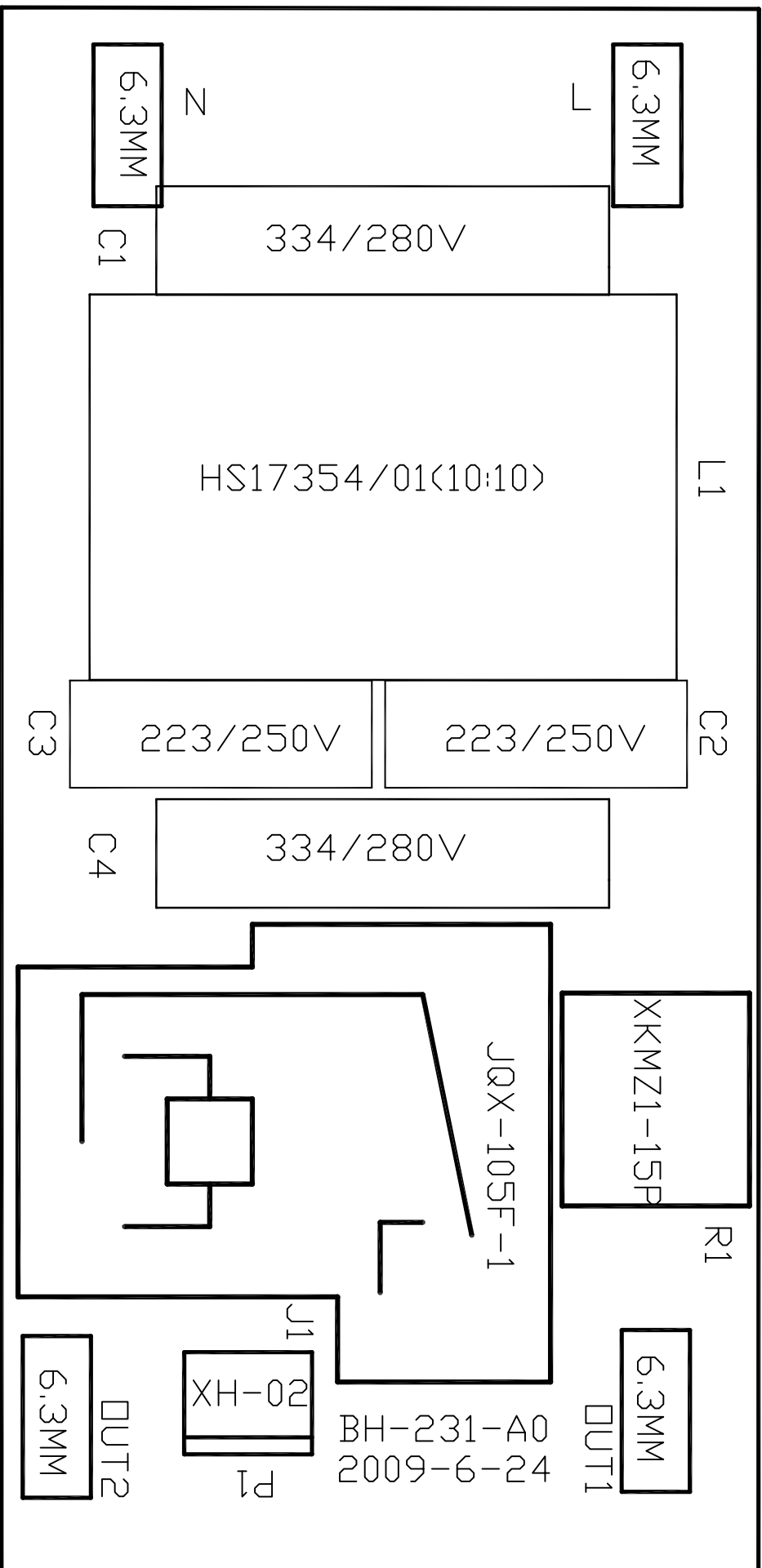
插件作业指导书

文件代号：WI-EN-J35-28

产品名称：MIG160 EMC板

版次：A2

第5页 共5页



检查说明：

1. 根据图示检查所有元件的规格和位置是否对应, 有无错件、漏件、反向、浮高等不良现象。
2. 所有元件表面没有明显破损和污渍且标示清晰可见, 检查并清除锡珠, 锡渣, 元件脚等不良。
3. 检查板底锡点有无空焊, 假焊, 虚焊, 虚焊, 短路等不良, 同一不良超过3次要向上级反馈:

注意事项：

1. 在更正错漏件时, 一定要确认所补上的元件规格与要求相符。
2. 检查时要注意核对PCB板上的位号, 且要重点检查与其它机型不一样的地方, 不能只看图上丝印位置。

有任何异常要及时通知工艺负责人或上级管理员